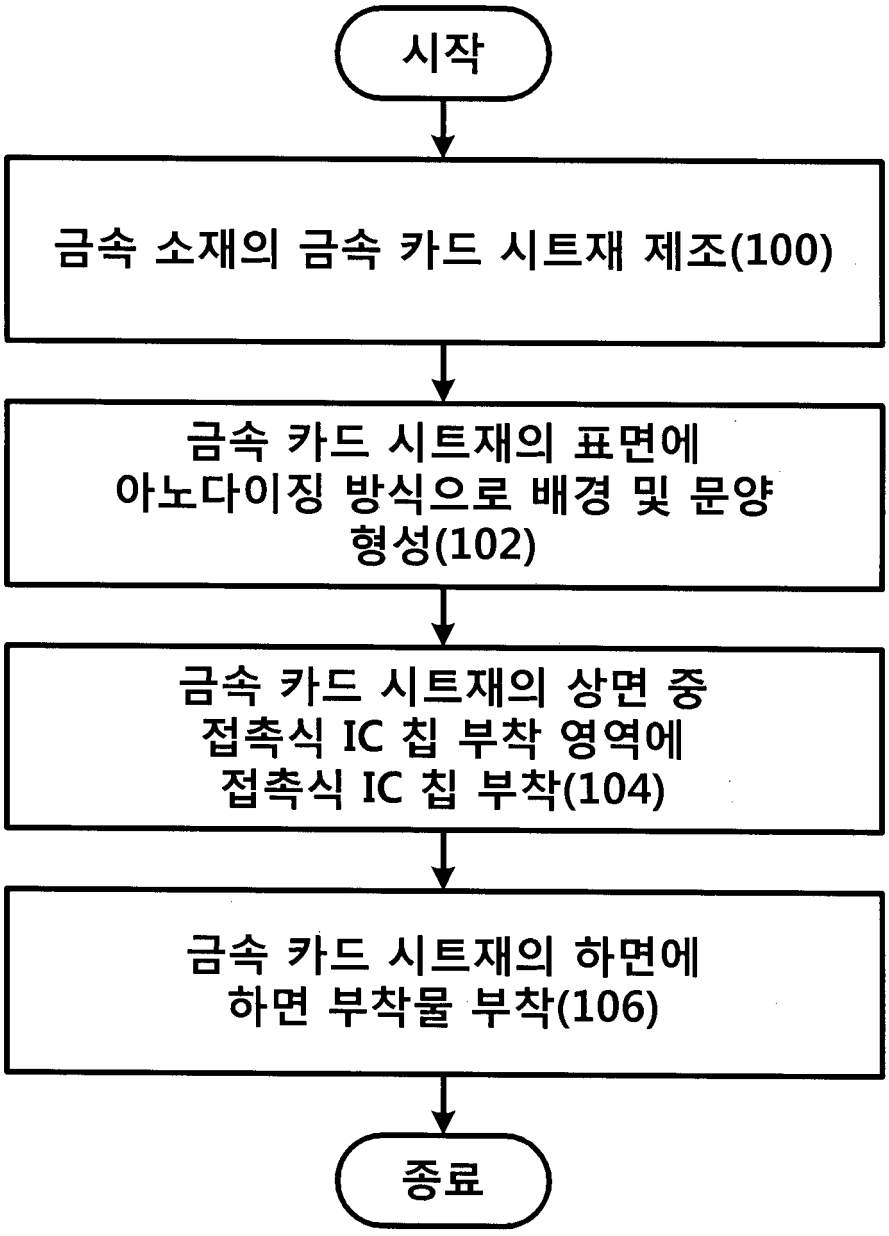
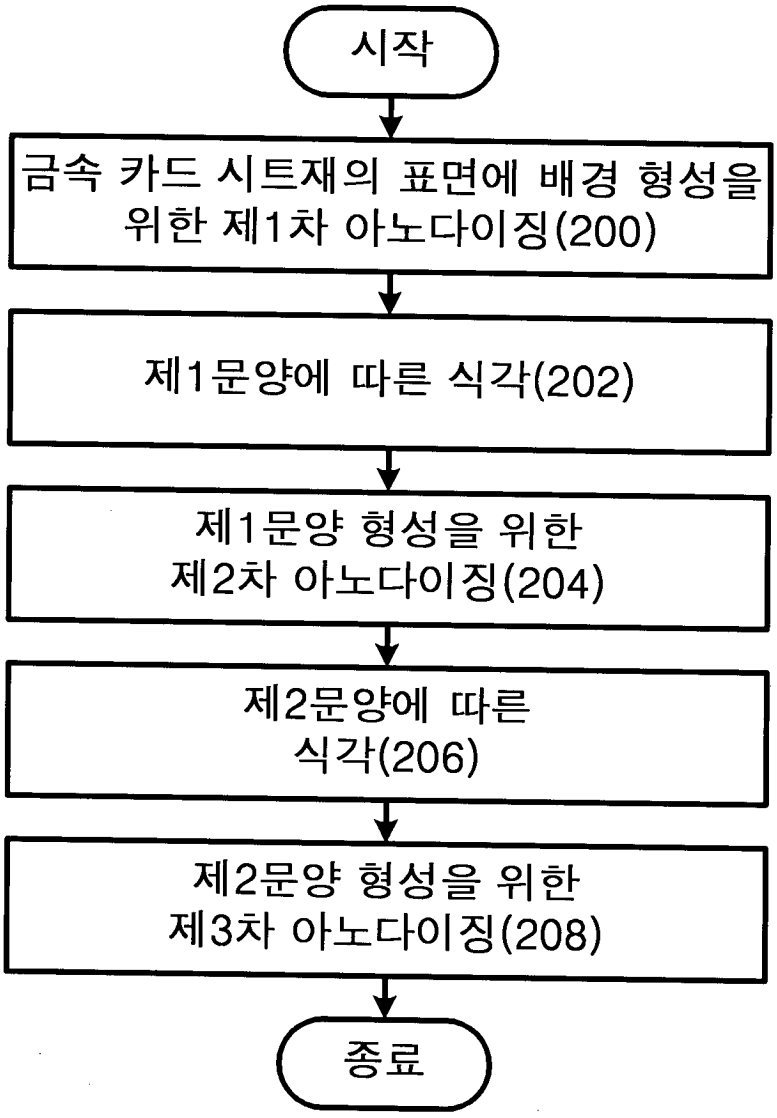
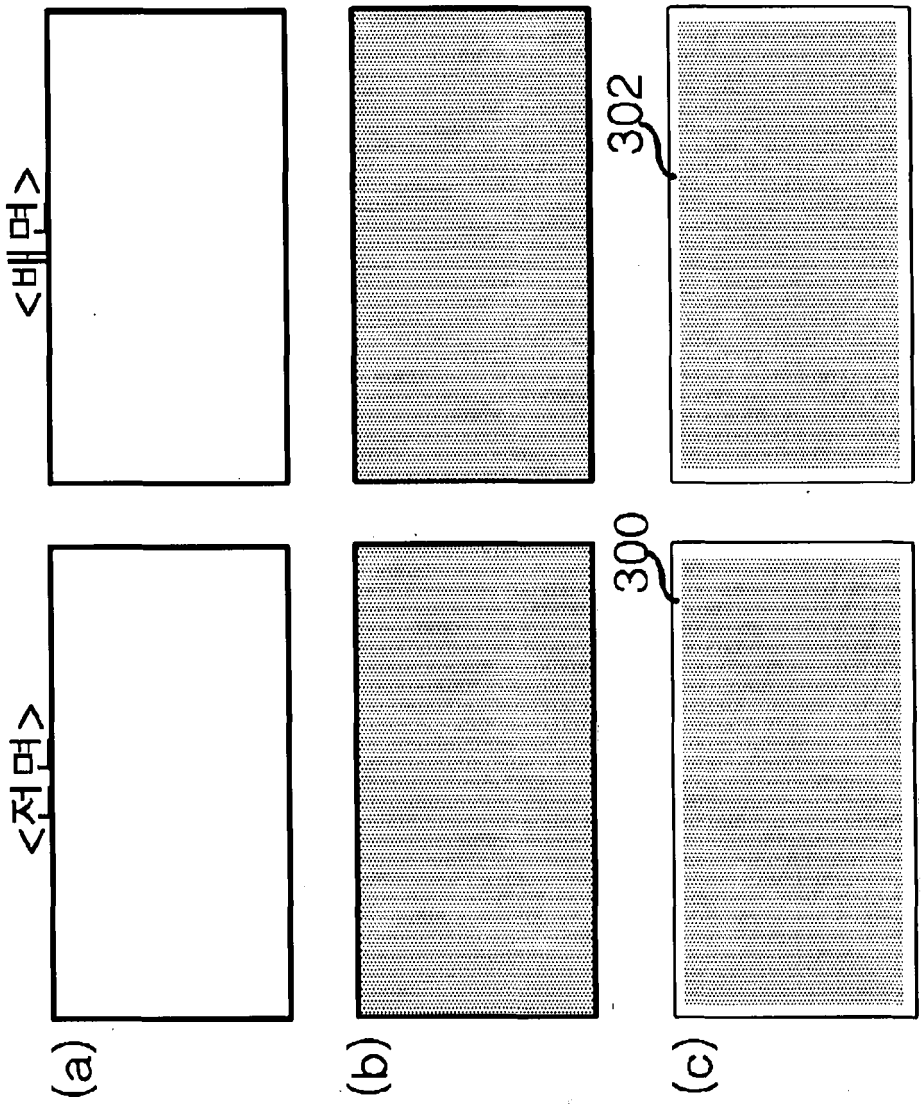
【도 1】


시작
금속 소재의 금속 카드 시트재 제조(100)
금속 카드 시트재의 표면에 아노다이징 방식으로 배경 및 문양 형성(102)
금속 카드 시트재의 상면 중 접촉식 IC 칩 부착 영역에 접촉식 IC 칩 부착(104)
금속 카드 시트재의 하면에 하면 부착물 부착(106)
종료

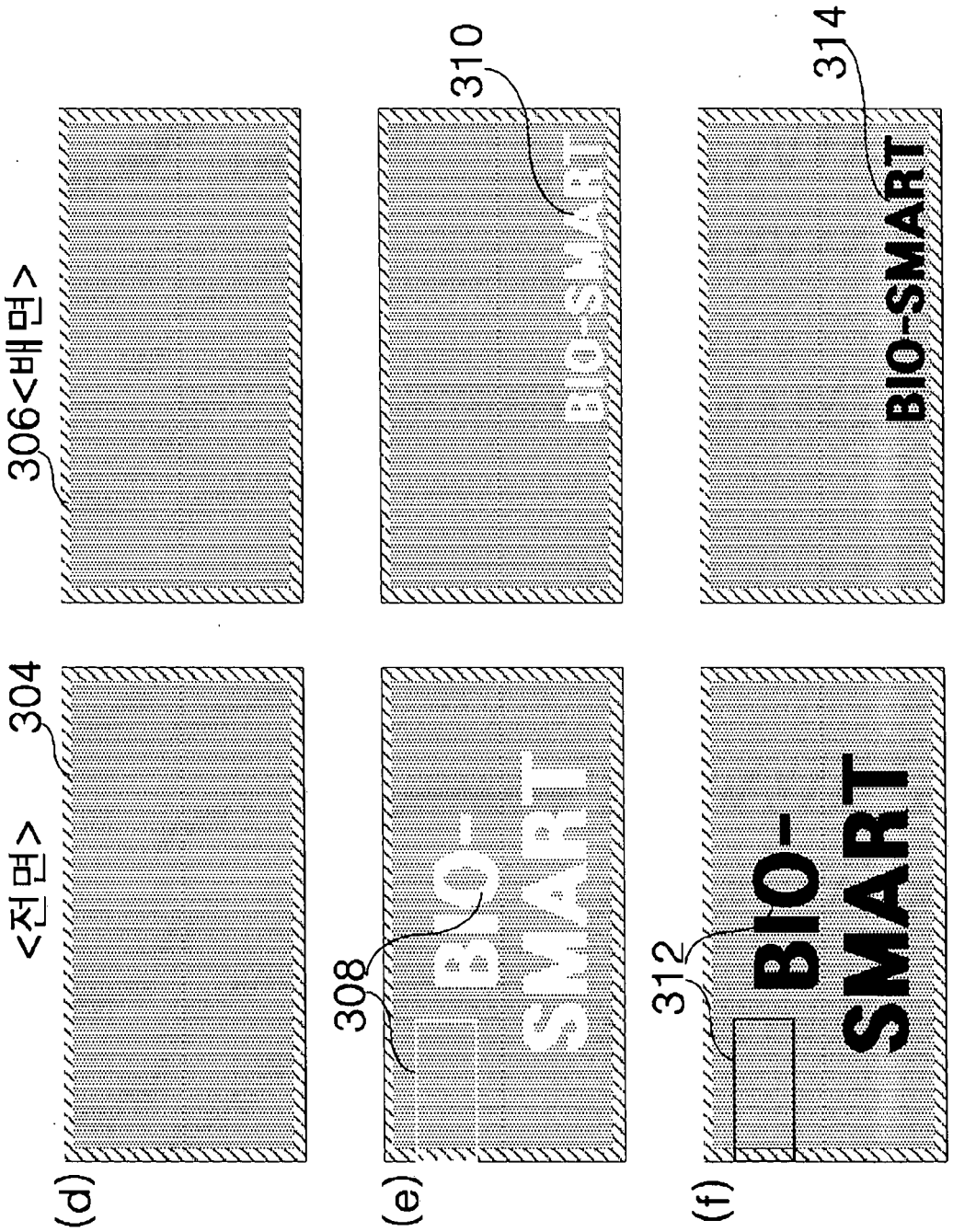
【도 2】


시작
금속 카드 시트재의 표면에 배경 형성을 위한 제1차 아노다이징(200)
제1문양에 따른 식각(202)
제1문양 형성을 위한 제2차 아노다이징(204)
제2문양에 따른 식각(206)
제2문양 형성을 위한 제3차 아노다이징(208)
종료

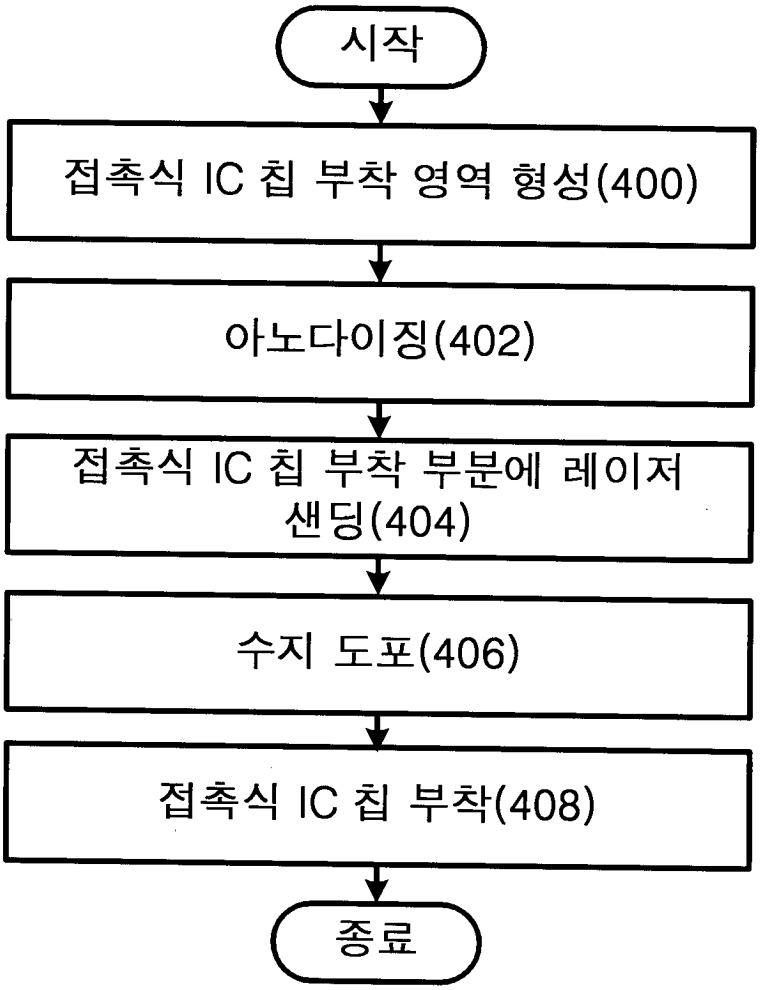
【도 3】



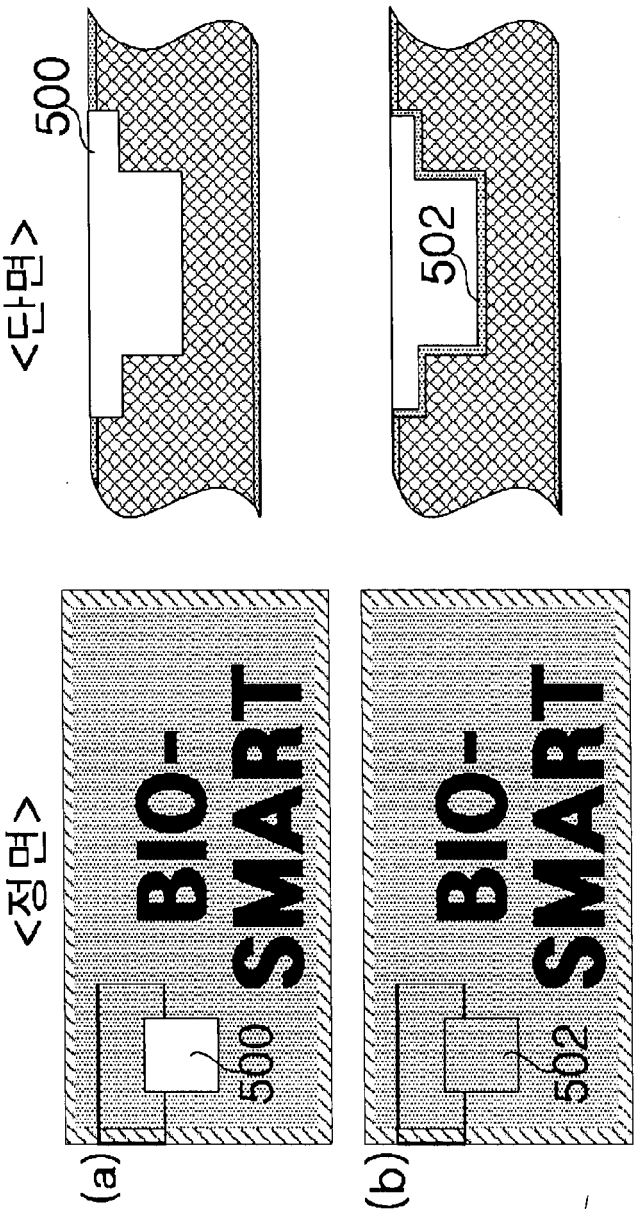
【도 4】



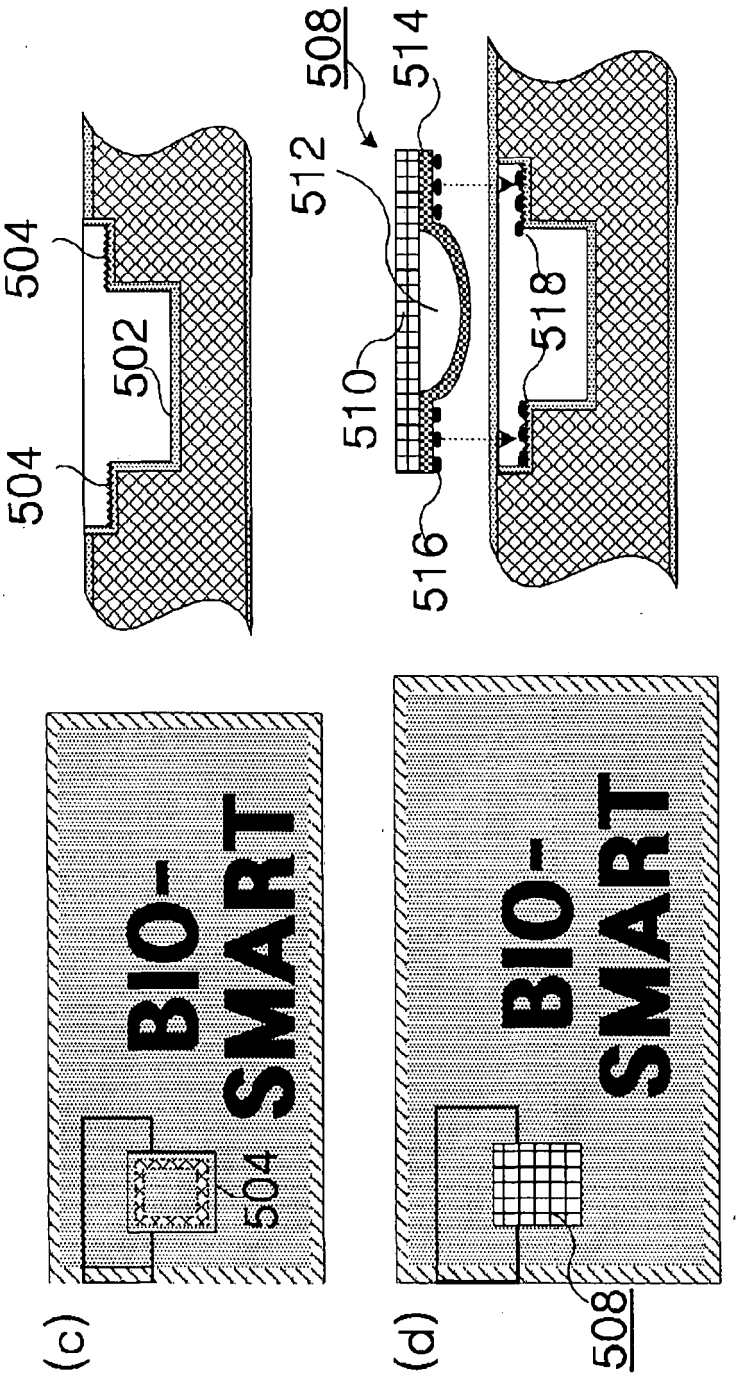
【도 5】


시작
접촉식 IC 칩 부착 영역 형성(400)
아노다이징(402)
접촉식 IC 칩 부착 부분에 레이저 샌딩(404)
수지 도포(406)
접촉식 IC 칩 부착(408)
종료

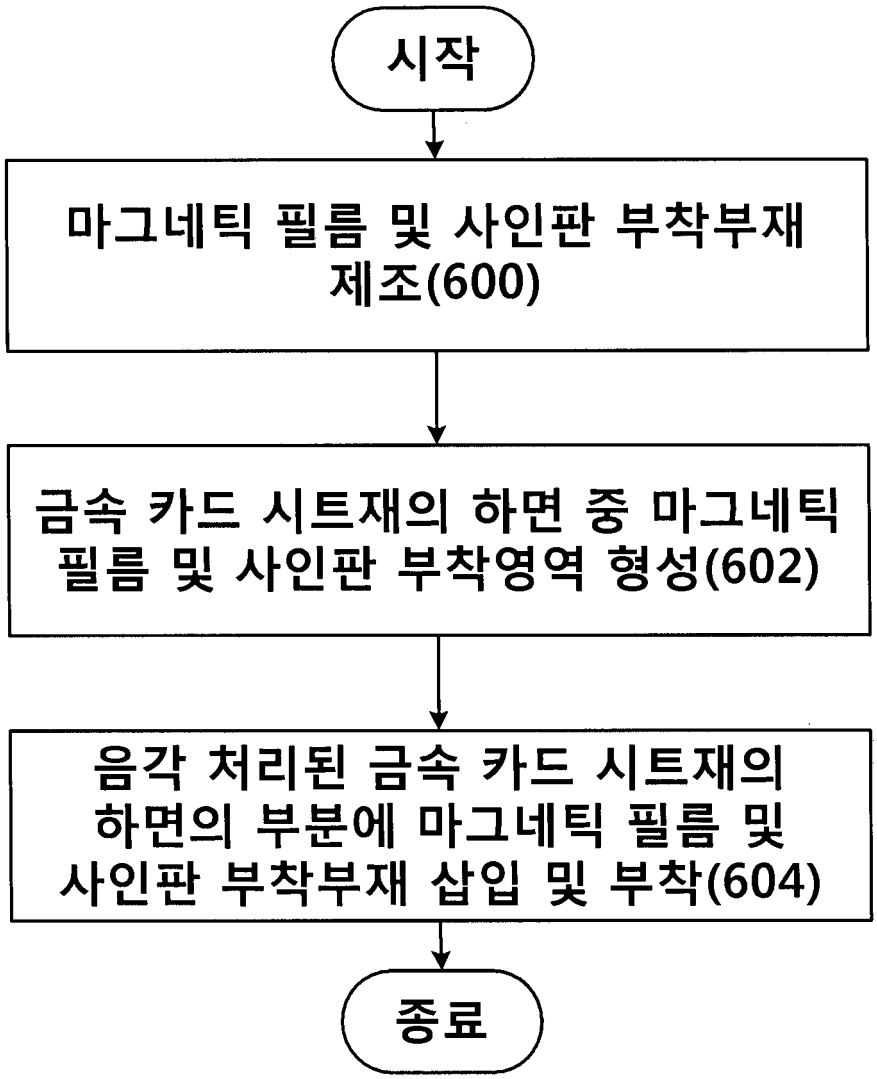
【도 6】



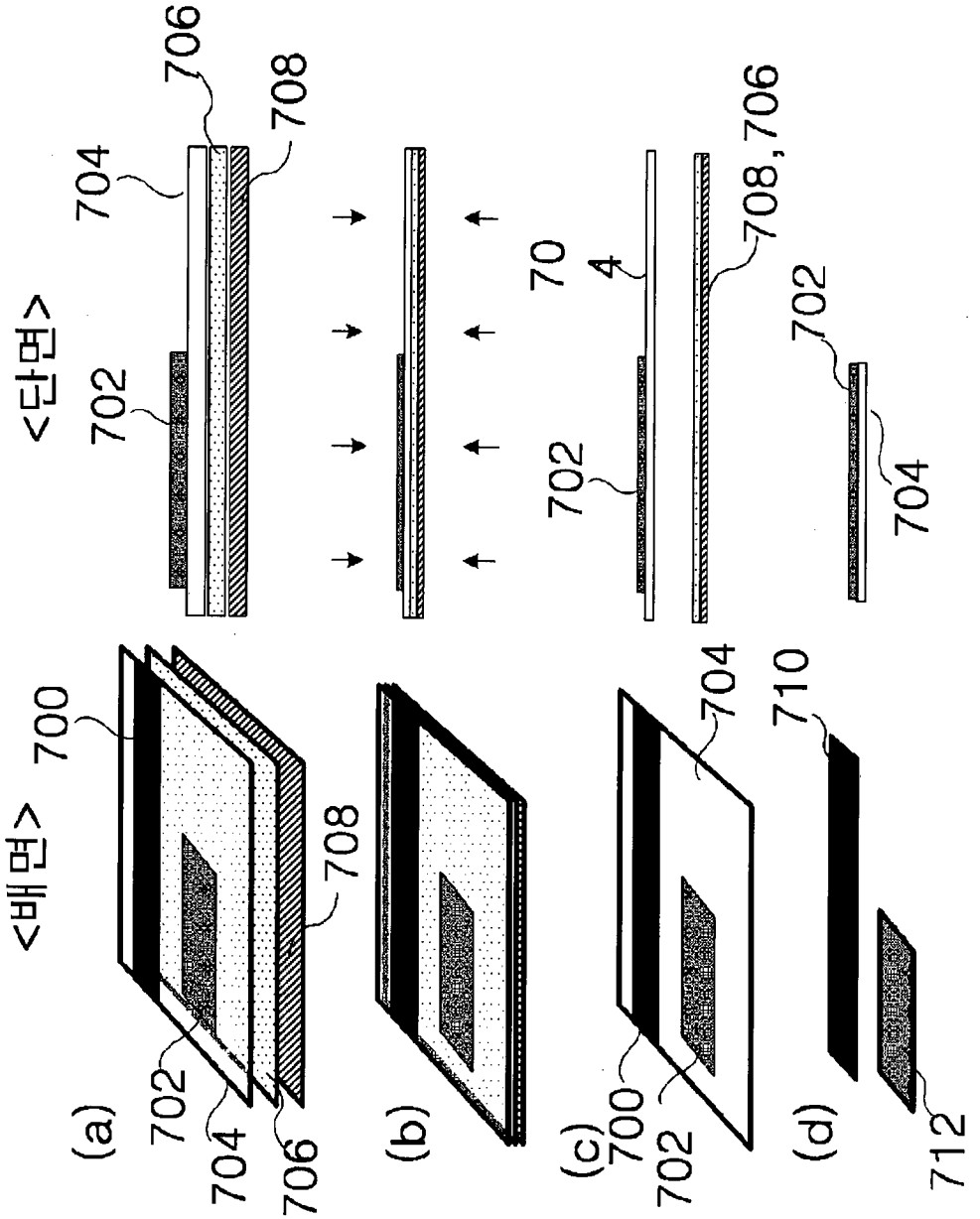
【도 7】


504
502
504
508
514
512
510
516
518
(c)
BIO-
SMART
504
(d)
BIO-
SMART
508

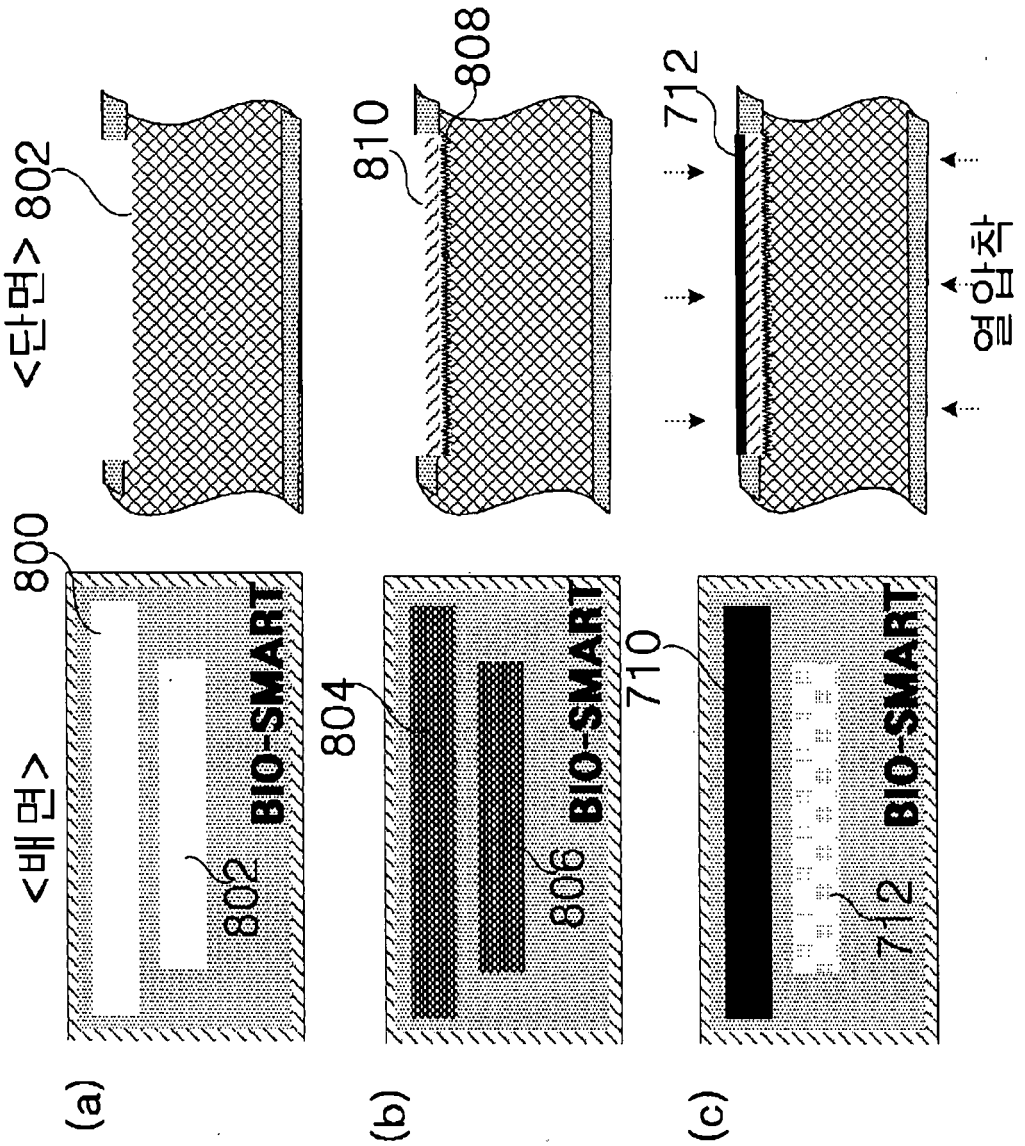
【도 8】


시작
마그네틱 필름 및 사인판 부착부재 제조(600)
금속 카드 시트재의 하면 중 마그네틱 필름 및 사인판 부착영역 형성(602)
음각 처리된 금속 카드 시트재의 하면의 부분에 마그네틱 필름 및 사인판 부착부재 삽입 및 부착(604)
종료

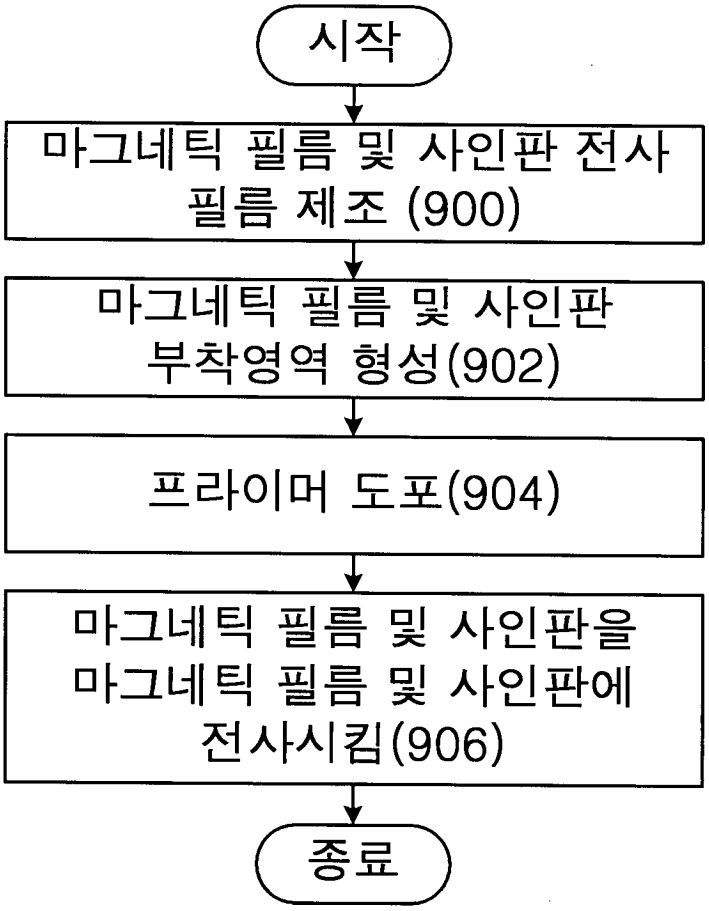
【도 9】



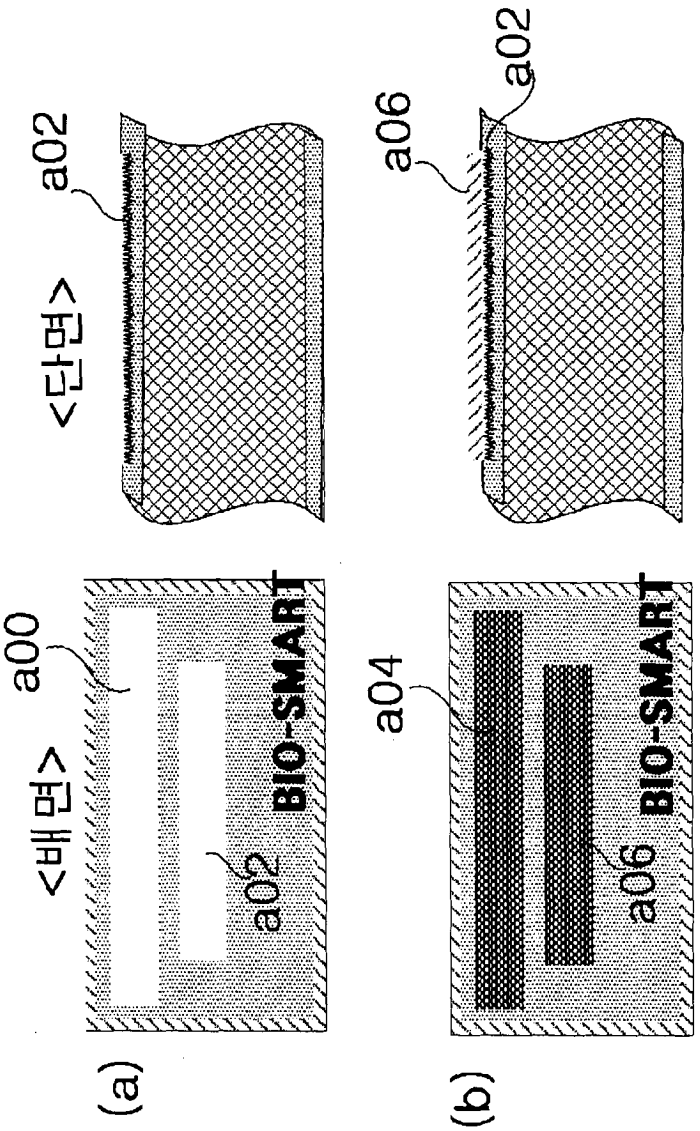
【도 10】


(a)
(b)
(c)
<배면>
800
802
BIO-SMART
804
806
BIO-SMART
710
712
BIO-SMART
<단면>
802
810
808
712
열압착

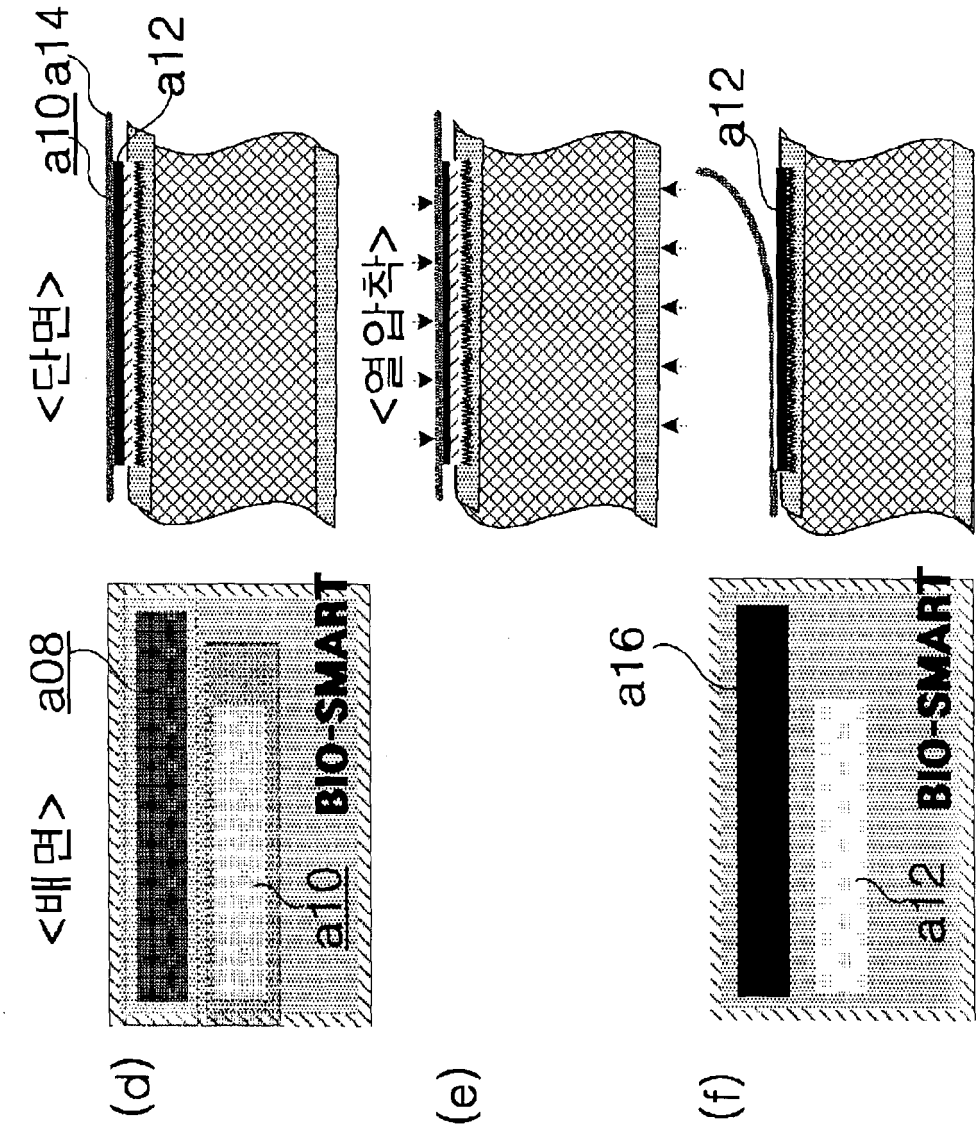
【도 11】


시작
마그네틱 필름 및 사인판 전사 필름 제조 (900)
마그네틱 필름 및 사인판 부착영역 형성(902)
프라이머 도포(904)
마그네틱 필름 및 사인판을 마그네틱 필름 및 사인판에 전사시킴(906)
종료

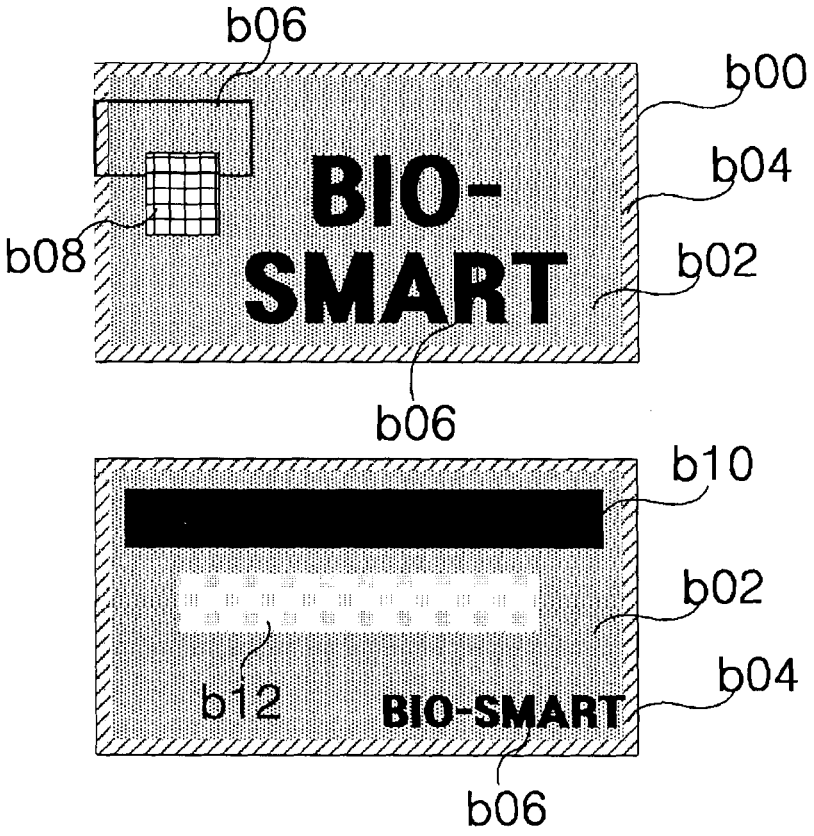
【도 12】



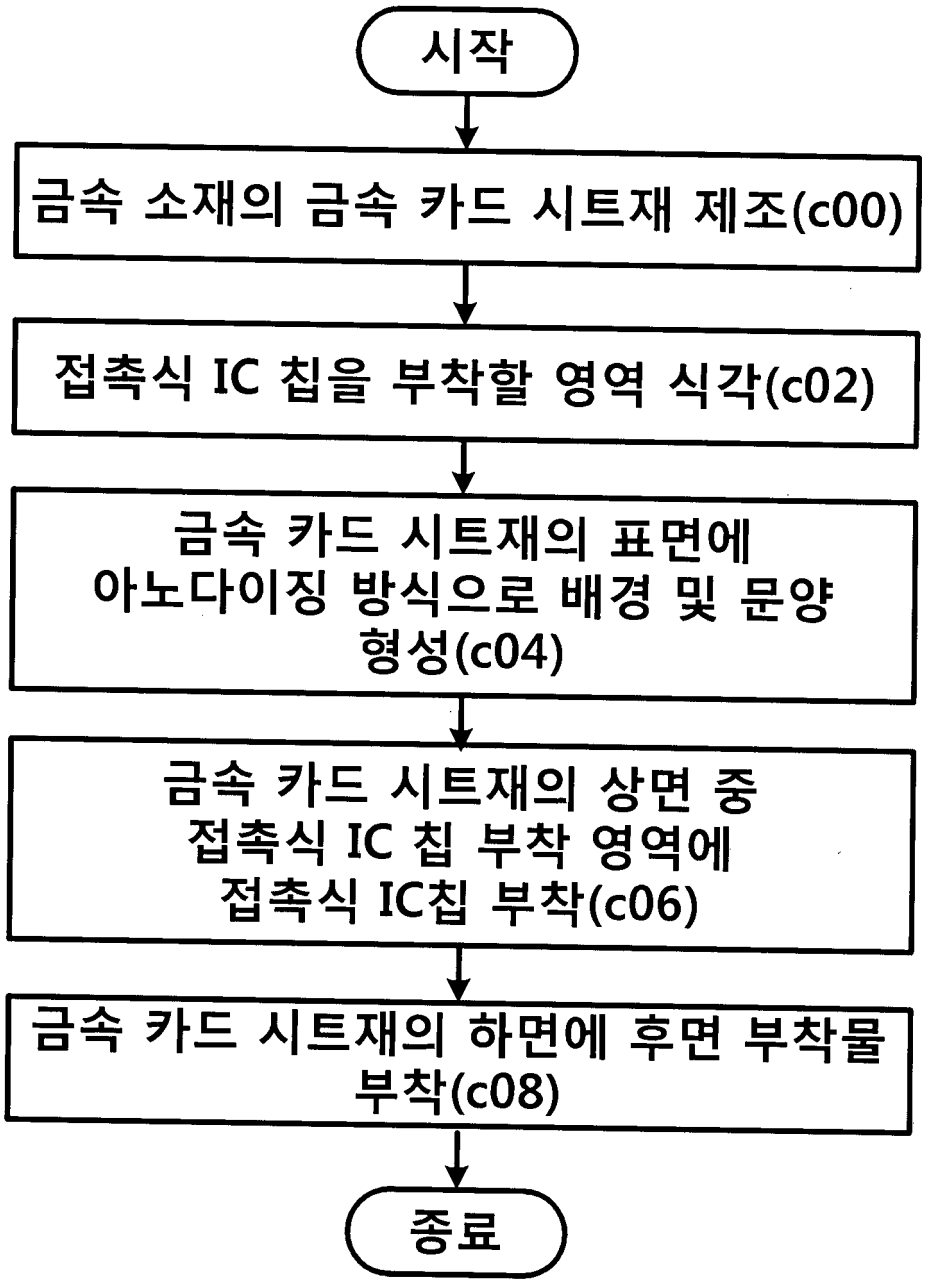
【도 13】


(d)
<배면>
a08
a10 BIO-SMART
<단면>
a10
a14
a12
(e)
<열압착>
(f)
a16
a12 BIO-SMART
a12

【도 14】



【도 15】


시작
금속 소재의 금속 카드 시트재 제조(c00)
접촉식 IC 칩을 부착할 영역 식각(c02)
금속 카드 시트재의 표면에 아노다이징 방식으로 배경 및 문양 형성(c04)
금속 카드 시트재의 상면 중 접촉식 IC 칩 부착 영역에 접촉식 IC칩 부착(c06)
금속 카드 시트재의 하면에 후면 부착물 부착(c08)
종료